

## 專利有效性技術分析簡表之說明與範例

111.11.8

### 【說明】

本簡表僅是臚列比對系爭專利與先前技術（引證）之技術特徵差異，仍須進一步判斷新穎性、進步性等要件。

例如進步性之判斷，須將系爭專利的整體與先前技術（引證）進行比對後，整體考量其差異處，以所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成客觀的判斷。

### 【範例一】

填表注意事項：

- 1、主張得撤銷之請求項有數項時，應逐項填列。
- 2、應就請求項各編號技術特徵具體填列引證資料相對應的內容，如認該編號技術特徵全部為引證資料所揭露，於「是否揭露」欄填列「○」，否則填「×」。
- 3、如認未揭露技術特徵，請於不同處以劃底線標示。

編號	系爭專利請求項 1	乙證 1	是否揭露
1A	一種無線射頻辨識電子標籤結構，包括：	一種無線射頻辨識標籤(100)；(第 7A 圖)	○
1B	一表面層，具有一第一表面及一第二表面，且互為相對面；	一 RFID 層(101)，具有第一表面以及第二表面，且互為相對面；(第 7A 圖)	○
1C	一印刷天線，位於該表面層的第一表面上；	一防偽線路(102)，位於該 RFID 層(101)之第一表面上(第 7A 圖)；說明書第 5 欄第 30 至 42 行說明防追	○

		偽線路(101)包含天線；	
1D	一無線射頻晶片，位於該第一表面上，並電氣連接至該印刷天線，以形成一無線射頻辨識裝置；	一 RFID 元件(402)，位於 RFID 層(101)之第一表面上，且電性連接至該防偽線路(102)；(第 7A 圖及說明書第 6 欄第 20 至 28 行)	○
1E	一接著層，係覆蓋該第一表面、該印刷天線及該無線射頻晶片；	一接著層 (103)，覆蓋 RFID 層(101)、防偽線路(102)及 RFID 元件(402)；(第 7A 圖)	○
1F	一離型層，位於該接著層上。		×

編號	系爭專利請求項 1	乙證 2	是否揭露
1A	一種無線射頻辨識電子標籤結構，包括：	一種無線射頻辨識標籤(1)；(第 1B 圖)	○
1B	一表面層，具有一第一表面及一第二表面，且互為相對面；	一基底薄片(13)，具有第一表面以及第二表面，且互為相對面；(第 1B 圖)	○
1C	一印刷天線，位於該表面層的第一表面上；	一天線線路(12)，位於該基底薄片(13)之第一表面上(第 1B 圖)；	○
1D	一無線射頻晶片，位於該第一表面上，並電氣連接至該印刷天線，以形成一無線射頻辨識裝置；	一積體電路晶片(11)，位於基底薄片(13)之第一表面上，且電性連接至該天線線路(12)；(第 1B 圖)	○

1E	一接著層，係覆蓋該第一表面、該印刷天線及該無線射頻晶片；	一接著層(15)，覆蓋該第一表面及天線線路(12)；(第 1B 圖)	×
1F	一離型層，位於該接著層上。	離型層，位於該接著層上(說明書第 6 欄第 30 至 35 載明可於接著層上設有離型層)	○

### 【範例二】

填表注意事項：

- 1、如引證資料眾多或相對應的文字內容過多時，可以簡表方式呈現。「○」表示已揭露相對應之技術特徵，「×」表示未揭露。
- 2、具體論證理由仍需載於書狀或表格下方。

編號	系爭專利請求項 1	乙證 1	乙證 2	乙證 3
1A	一種移除失效型無線射頻辨識電子標籤結構，包括：	○	○	○
1B	一表面層，具有一第一表面及一第二表面，且互為相對面；	○	○	○
1C	一印刷天線，位於該表面層的第一表面上；	○	○	○
1D	一無線射頻晶片，位於該第一表面上，並電氣連接至該印刷天線，以形成一無線射頻辨識裝置；	○	○	○

1E	一接著層，係覆蓋該第一表面、該印刷天線及該無線射頻晶片；	○	×	○
1F	一離型層，位於該接著層上。	×	○	×

一、乙證 1 及乙證 2 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

- (一)乙證 1 說明書第 4 欄第 5 至 20 行…
- (二)乙證 2 第 1B 圖…
- (三)乙證 1、2 之組合動機…
- (四)…

二、乙證 1 及乙證 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：…